

2026 年 5 月 24 日

新一代服务器拉动 PCB，产业链开启高增长

计算机行业周报

本周观点：

新一代服务器拉动 PCB 需求增长

根据财联社，华尔街对英伟达下一代 Rubin 机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，从 ODM 处采购的 Rubin 机架售价约为 780 万美元，较上一代 GB300 机架的约 399 万美元几乎翻倍。其中 VR200 的机柜 PCB 价值量 11.6 万美元，较 GB300 的机柜 PCB 价值量（3.5 万美元）翻 3 倍。VR200 的 PCB 成本相较于 GB300 出现了高达 233% 以上的巨幅增长。这将使总 PCB 耗用价值提升至约 11.7 万美元，而相比之下 GB300 仅为 3.5 万美元。这一显著的成本跃升是由 PCB 数量的增加所驱动的，其中引入了诸如 ConnectX 模块和中板 PCB 等新模块，同时 PCB 的层数和覆铜板（CCL）等级也迎来了升级。

ASIC 单芯片提升对应量

根据 DIGITIMES Asia 最新报告，全球数据中心 AI 芯片出货量预计将从 2024 年的 3050 万片增长至 2030 年的 5340 万片，其中 AI 芯片包括高端与中端 GPU、专用 AI 芯片（如谷歌 TPU）、AI 服务器 CPU，以及网络与互连相关芯片。Decode 节点需要更高密度的 HBM 显存封装基板与更高速的片间互联（NV Link/C2C），Prefill 节点则需要支持更高功率密度的供电与散热方案，二者共同推动 PCB 从传统的连接载体升级为决定系统性能瓶颈的关键半导体级组件。

国产 PCB 产业链长坡厚雪

PCB 上游原材料中覆铜板成本占 PCB 生产成本的 30%-40%，其自身成本构成中，铜箔（42.1%）、树脂（26.1%）、玻纤布（19.1%）合计占比达 87.3%，原材料价格波动对覆铜板成本影响显著。5 月份以来，行业迎来新一轮集中提价，上游覆铜板、高端铜箔、电子布及特种树脂等原材料价格继续上行，带动 PCB 成品价格同步走高。随着覆铜板 CCL 全面涨价各大厂商相应调价，全球电子铜箔也正进入高端产品（HVLP 系列/RTF 系列）上涨、各类铜箔产品价格普遍上涨、加工费持续上行的行业周期。锂电铜箔和电子电路铜箔双双涨价，加工费普遍上调 1500-5000 元/吨，部分高端产品涨价幅度超 30%，总体来说，2026 年供需缺口比 2025 年更大，尤其在 AI 算力硬件需求背景下，HVLP 高端铜箔供不应求。

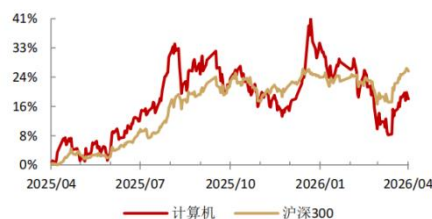
投资建议

受益标的：

评级及分析师信息

行业评级：推荐

行业走势图



分析师：刘泽晶

邮箱：liuzj1@hx168.com.cn

SAC NO: S1120520020002

分析师：孟令儒奇

邮箱：menglrq@hx168.com.cn

SAC NO: S1120524060001

PCB 制造：胜宏科技、沪电股份、深南电路、鹏鼎控股、东山精密、景旺电子、广合科技；

材料：生益科技、宏和科技、金安国纪、南亚新材；

设备耗材：鼎泰高科、大族数控、东威科技、芯碁微装、天承科技；

PCB 检测设备：奕瑞科技，日联科技。

风险提示

市场系统性风险、科技创新政策落地不及预期、中美博弈突发事件。

盈利预测与估值

重点公司											
股票代码	股票名称	收盘价 (元)	投资 评级	EPS (元)				P/E			
				2024A	2025A	2026E	2027E	2024A	2025A	2026E	2027E
600588.SH	用友网络	10.87	买入	-0.60	-0.12	1.20	1.40	-18	-91	9	8
688111.SH	金山办公	242.10	买入	3.56	4.07	5.43	5.11	68	59	45	47
300454.SZ	深信服	115.79	买入	0.47	1.01	1.50	2.11	246	115	77	55
600570.SH	恒生电子	25.83	买入	0.55	0.62	0.92	1.32	47	42	28	20
300803.SZ	指南针	98.19	买入	0.25	0.50	0.75	0.93	393	196	131	106
300033.SZ	同花顺	226.87	买入	3.39	4.93	6.32	8.33	67	46	36	27
300674.SZ	宇信科技	18.06	买入	0.54	0.67	0.83	1.22	33	27	22	15
300496.SZ	中科创达	71.65	买入	0.89	1.15	1.55	2.54	81	62	46	28
002920.SZ	德赛西威	110.50	买入	3.61	4.39	5.74	6.77	31	25	19	16
002405.SZ	四维图新	9.46	买入	-0.46	-0.26	1.3	2.5	-21	-36	7	4
688777.SH	中控技术	86.16	买入	0.78	0.99	1.32	1.88	110	87	65	46
002230.SZ	科大讯飞	47.35	买入	0.24	0.38	0.76	1.23	197	125	62	38
300682.SZ	朗新科技	14.27	买入	-0.23	0.44	0.99	1.23	-62	32	14	12
600570.SH	恒生电子	25.83	买入	1.17	0.62	0.5	0.44	22	42	52	59
688095.SH	福昕软件	77.40	买入	0.28	0.53	0.43	1.20	276	146	180	65

资料来源：Wind、华西证券研究所

注：朗新科技（与通信联合覆盖）、金山办公（与中小盘联合覆盖）、指南针（与非银联合覆盖）。

正文目录

1. 新一代服务器拉动 PCB，产业链开启高增长	4
2. 新一代服务器拉动 PCB 需求增长	5
2.1. 英伟达 NVL72 单机柜成本翻倍跃升	5
2.2. ASIC 芯片提升单芯片对应 PCB 价值量	7
3. 国产 PCB 产业链长坡厚雪	9
3.1. 国产 PCB 产业链量价齐升	9
3.2. 投资建议	15
4. 本周行情回顾	16
4.1. 行业周涨跌及成交情况	16
4.2. 个股周涨跌、成交及换手情况	17
4.3. 核心推荐标的的行情跟踪	18
4.4. 整体估值情况	19
5. 本周重要公告汇总	20
6. 本周重要新闻汇总	23
7. 历史报告回顾	32
8. 风险提示	34

图表目录

图表 1 VR200 NVL72 机柜 BOM 拆解，PCB 价值量提升 233%	5
图表 2 VR200 PCB 量	6
图表 3 NVIDIA NVL576 机架	7
图表 4 预填充与解码时的内部 GPU 状态	8
图表 5 CoWoP 方案中，PCB 承担了原本封装基板的全部功能	9
图表 6 PCB 分类	10
图表 7 PCB 产业链全景图	11
图表 8 鼎泰高科华南总部（二期）项目正式投产	12
图表 9 奕瑞科技平面 CT 检测系统	14
图表 10 日联科技纳米级智检装备	15
图表 11 申万一级行业指数涨跌幅（%）（本周）	16
图表 12 申万一级行业指数涨跌幅（%）（2026 年初至今）	17
图表 13 计算机行业周平均日成交额（亿元）	17
图表 14 申万计算机行业周涨幅前五（%）（本周）	18
图表 15 申万计算机行业周跌幅前五（%）（本周）	18
图表 16 申万计算机行业周成交额前五（亿元）	18
图表 17 申万计算机行业周均换手率前五（%）	18
图表 18 本周核心推荐标的的行情	19
图表 19 申万计算机行业估值情况（2010 年至今）	20

1. 新一代服务器拉动 PCB，产业链开启高增长

一、新一代服务器拉动 PCB 需求增长

根据财联社，华尔街对英伟达下一代 Rubin 机架进行了全面的物料清单(BOM)拆解，从 ODM 处采购的 Rubin 机架售价约为 780 万美元，较上一代 GB300 机架的约 399 万美元几乎翻倍。其中 VR200 的机柜 PCB 价值量 11.6 万美元，较 GB300 的机柜 PCB 价值量（3.5 万美元）翻 3 倍。VR200 的 PCB 成本相较于 GB300 出现了高达 233% 以上的巨幅增长。这将使总 PCB 耗用价值提升至约 11.7 万美元，而相比之下 GB300 仅为 3.5 万美元。这一显著的成本跃升是由 PCB 数量的增加所驱动的，其中引入了诸如 ConnectX 模块和中板 PCB 等新模块，同时 PCB 的层数和覆铜板(CCL)等级也迎来了升级。

二、ASIC 单芯片提升对应量

根据 DIGITIMES Asia 最新报告，全球数据中心 AI 芯片出货量预计将从 2024 年的 3050 万片增长至 2030 年的 5340 万片，其中 AI 芯片包括高端与中端 GPU、专用 AI 芯片（如谷歌 TPU）、AI 服务器 CPU，以及网络与互连相关芯片，例如交换芯片、机架级互连芯片、DPU 和智能网卡。Decode 节点需要更高密度的 HBM 显存封装基板与更高速的片间互连（NV Link/C2C），Prefill 节点则需要支持更高功率密度的供电与散热方案，二者共同推动 PCB 从传统的连接载体升级为决定系统性能瓶颈的关键半导体级组件。

三、国产 PCB 产业链长坡厚雪

印制电路板（PCB）的主要作用是使各种电子零组件形成预订电路的连接。PCB 是电子产品零件装载的基板，为电子元器件提供支撑并提供电气连接，是几乎所有电子设备的基础必需品。国内某头部 PCB 上市公司高管向财联社记者表示，“AI PCB 相关的产品确实需求很好，比如 18 层以上 PCB、高阶 HDI、封装基板的需求也好起来了，如果没有极端情况出现，全球 AI 投资还会持续，高端 PCB 的产品还是会面临比较长的高景气度。”这在行业公司的一季度业绩中已有所体现，多数沾上这波增长红利企业盈利改善明显，净利润实现同比倍增，归因表述中多提及“AI”“业务量增加”等。沙利文中国高级合伙人兼董事总经理贾庞认为，AI 服务器 PCB 层数持续上行、M9 材料渗透率提升，双重因素叠加推高单板耗针量；供给端，超微径高端钻针的全球产能主要掌握在日系厂商手中，短期难以大幅扩产，供需错配格局为价格提供持续支撑。

四、投资建议

受益标的：

PCB 制造：胜宏科技、沪电股份、深南电路、鹏鼎控股、东山精密、景旺电子、广合科技；

材料：生益科技、宏和科技、金安国纪、南亚新材；

设备耗材：鼎泰高科、大族数控、东威科技、芯基微装、天承科技；

PCB 检测设备：奕瑞科技，日联科技。

2. 新一代服务器拉动 PCB 需求增长

根据财联社, 华尔街对英伟达下一代 Rubin 机架进行了全面的物料清单(BOM)拆解, 从 ODM 处采购的 Rubin 机架售价约为 780 万美元, 较上一代 GB300 机架的约 399 万美元几乎翻倍。其中 VR200 的机柜 PCB 价值量 11.6 万美元, 较 GB300 的机柜 PCB 价值量 (3.5 万美元) 翻 3 倍。VR200 的 PCB 成本相较于 GB300 出现了高达 233% 以上的巨幅增长。这将使总 PCB 耗用价值提升至约 11.7 万美元, 而相比之下 GB300 仅为 3.5 万美元。这一显著的成本跃升是由 PCB 数量的增加所驱动的, 其中引入了诸如 ConnectX 模块和中板 PCB 等新模块, 同时 PCB 的层数和覆铜板 (CCL) 等级也迎来了升级。根据 DIGITIMES Asia 最新报告, 全球数据中心 AI 芯片出货量预计将从 2024 年的 3050 万片增长至 2030 年的 5340 万片, 其中 AI 芯片包括高端与中端 GPU、专用 AI 芯片 (如谷歌 TPU)、AI 服务器 CPU, 以及网络与互连相关芯片。Decode 节点需要更高密度的 HBM 显存封装基板与更高速的片间互联 (NV Link/C2C), Prefill 节点则需要支持更高功率密度的供电与散热方案, 二者共同推动 PCB 从传统的连接载体升级为决定系统性能瓶颈的关键半导体级组件。

2.1. 英伟达 NVL72 单机柜成本翻倍跃升

根据财联社, 华尔街对英伟达下一代 Rubin 机架进行了全面的物料清单(BOM)拆解, 从 ODM 处采购的 Rubin 机架售价约为 780 万美元, 较上一代 GB300 机架的约 399 万美元几乎翻倍。自英伟达首次推出 GB200 NVL72 以来, 内存价格已大幅上涨。按照旧的内存价格计算, 内存在 GB200 NVL72 机架的物料清单中仅占 5% 至 10%; 但在内存用量增加以及目前定价大幅提升的情况下, 内存在 VR200 机架的物料清单中已占据了 25% 至 30% 的巨额比重。

在其覆盖的下游零部件中, PCB 内容价值增幅最为显著, 较 GB300 大涨 233%, 其次是 MLCC (+182%)、ABF 基板 (+82%)、电源 (+32%) 以及液冷组件 (+12%)。

图表 1 VR200 NVL72 机柜 BOM 拆解, PCB 价值量提升 233%

Nvidia NVL72 Bill of Materials	GB300	VR200	Diff.
GPU	\$2,520,000	\$3,960,000	57%
CPU	\$180,000	\$180,000	0%
NVLink Switch chip	\$64,800	\$144,000	122%
Other networking chips	\$261,000	\$576,000	121%
Memory	\$373,939	\$2,001,600	435%
Cooling	\$64,610	\$72,080	12%
Power supply	\$57,600	\$76,000	32%
PCB	\$35,100	\$116,730	233%
ABF Substrate	\$11,160	\$20,340	82%
MLCC	\$1,530	\$4,320	182%
Others	\$402,412	\$623,278	55%
Rack assembly value add	\$22,400	\$28,800	29%
Total	\$3,994,551	\$7,803,148	95%

资料来源: 财联社公众号, 华西证券研究所

VR200 的 PCB 成本相较于 GB300 出现了高达 233% 以上的巨幅增长。这将使总 PCB 耗用价值提升至约 11.7 万美元，而相比之下 GB300 仅为 3.5 万美元

这一显著的成本跃升是由 PCB 数量的增加所驱动的，其中引入了诸如 ConnectX 模块和中板 PCB 等新模块，同时 PCB 的层数和覆铜板 (CCL) 等级也迎来了升级。例如：计算板 (computing board) 将从 GB300 的 22 层 HDI PCB 升级为 26 层；覆铜板等级从 Blackwell 系列的 M7 升级到了 M8。此外，计算板的尺寸也比 Blackwell 略大。交换机托盘 PCB 从 Blackwell 的 24 层板升级到 32 层板。所有这些因素都促成了 PCB 成本的显著增长。此外，计算托盘中还引入了全新的中架 PCB (44 层)，这在先前的 GB300 机架中是不存在的，它同样为成本的增长带来了贡献。Rubin Ultra NVL576 开始用一整块 78 层 M9 级正交背板取代铜缆，承担机柜内 GPU 的全互联通信，PCB 由此从板级组件跃升为机架级核心互联介质。

图表 2 VR200 PCB 量

Exhibit 4: VR200 PCB Content is 200%+ higher than that of GB300

PCB ASP per board (US\$)	GB300	VR200
Compute PCB	\$650	\$1,400
Switch PCB	\$800	\$1,450
Midplane PCB	\$0	\$1,500
BlueField PCB	\$0	\$255
ConnectX PCB	\$0	\$270
Other peripheral PCB	\$50	\$50
PCB Units per rack	GB300	VR200
Compute PCB	36x	36x
Switch PCB	9x	9x
Midplane PCB	0x	18x
BlueField PCB	18x	18x
ConnectX PCB	0x	72x
Other peripheral PCB	90x	45x
Total PCB Content per rack	GB300	VR200
Compute PCB	\$23,400	\$50,400
Switch PCB	\$7,200	\$13,050
Midplane PCB	\$0	\$27,000
BlueField PCB	\$0	\$4,590
ConnectX PCB	\$0	\$19,440
Other peripheral PCB	\$4,500	\$2,250
Total PCB Content per rack	\$35,100	\$116,730

资料来源：财联社公众号，华西证券研究所

正交背板 (Orthogonal Backplane) 是 Rubin Ultra 最具产业意义的工程创新之一，也是 PCB “半导体化” 的标志性事件。据台积电披露，Rubin Ultra 在 Kyber 架构中引入正交背板，通过 78 层 PCB 实现 GPU 与 NV Switch 的互连，替代数万根

铜缆，支撑更高密度的单机柜算力集成。

图表 3 NVIDIA NVL576 机架



资料来源：策金说公众号，华西证券研究所

数量上，Rubin Ultra NVL576 机架内集成 144 颗 GPU 封装（576 个 GPU 计算单元），是 NVL72 的 2 倍，直接拉动 PCB 用量翻倍。

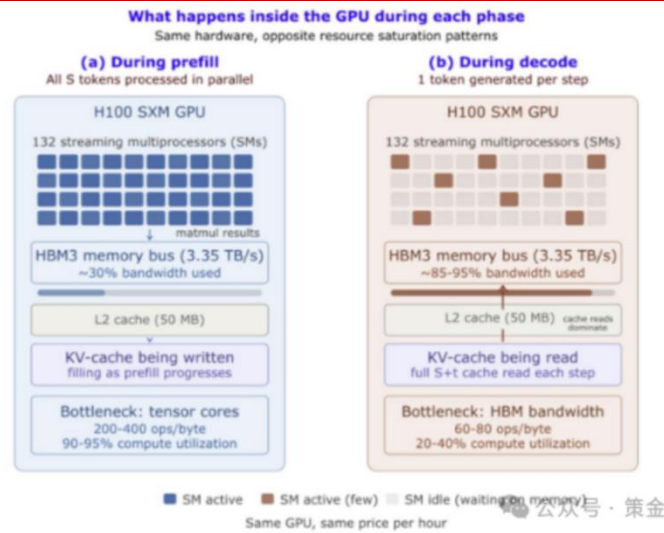
价值上，以 Rubin 平台为例，其为达成低损耗与低延迟，全面升级使用材料，包括 Switch Tray 采用 M8U 等级（Low-DK2+HVLP4）和 24 层 HDI 板设计，Midplane 与 CX9/CPX 则导入 M9（Q-glass+ HVLP4），层数最高达 104 层。这让单台服务器的 PCB 价值比上一代提升超过两倍。

2.2.ASIC 芯片提升单芯片对应 PCB 价值量

根据 DIGITIMES Asia 最新报告，全球数据中心 AI 芯片出货量预计将从 2024 年的 3050 万片增长至 2030 年的 5340 万片，其中 AI 芯片包括高端与中端 GPU、专用 AI 芯片（如谷歌 TPU）、AI 服务器 CPU，以及网络与互连相关芯片，例如交换芯片、机架级互连芯片、DPU 和智能网卡。

从 AI 计算底层物理特性来看，Transformer 架构下大模型推理严格分为 Prefill 与 Decode 两个阶段，二者硬件资源消耗特征存在显著不对称。

图表 4 预填充与解码时的内部 GPU 状态



资料来源：策金说公众号，华西证券研究所

Decode 节点需要更高密度的 HBM 显存封装基板与更高速的片间互联（NV Link/C2C），Prefill 节点则需要支持更高功率密度的供电与散热方案，二者共同推动 PCB 从传统的连接载体升级为决定系统性能瓶颈的关键半导体级组件。

在芯片层面，HBM4 的引入要求中介层和封装基板支持千位级 I/O 接口，信号完整性要求已逼近半导体封装基板标准。

在封装层面，CoWoS-L 向 CoWoP 的演进让 PCB 首次承担起类基板的功能，层间对位精度与线宽线距向先进封装看齐。

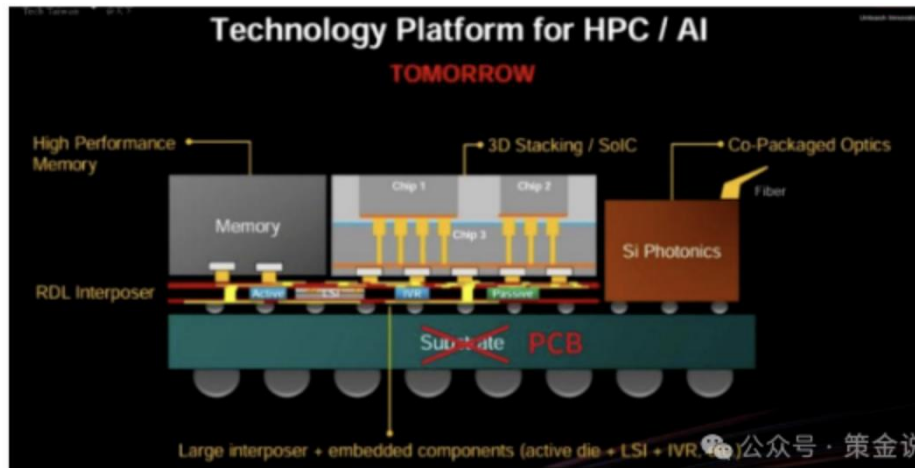
在板卡层面，以 GB300 为例，服务器 PCB 层数从传统的 10 层左右跃升至 20 层以上，部分高端型号采用 34 至 64 层超高层设计，技术难度呈指数级攀升。

随着 AI 服务器升级，GPU 主板也将逐步升级为 HDI，小型 AI 加速器模组通常使用 4-5 阶的 HDI 来达到高密度互联，因此 HDI 将是未来 5 年 AI 服务器相关增速最快的 PCB，特别是 4 阶以上的高阶 HDI 产品需求增速快。

AI 服务器的 PCB 价值增量主要集中于 GPU 模组，相关主要 PCB 层数不仅提升至 20-30 层，同时，CCL 材料等级也有望进一步提升至 Ultra Low Loss。

CoWoP (Chip-on-Wafer-on-PCB) 是 2025 年下半年开始引发业内剧烈讨论的新一代先进封装方案，其核心思路简洁却具革命性：在传统 CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) 方案中去掉 ABF 封装基板与 BGA 焊球，将硅中介层与 GPU/HBM 组合直接安装在强化型基板级 PCB 上。

图表 5 CoWoP 方案中，PCB 承担了原本封装基板的全部功能



资料来源：策金说公众号，华西证券研究所

在布线精度层面，采用 mSAP（改良型半加成法）工艺的 AI 服务器 PCB 已将最小线宽/线距压缩至 $10\ \mu\text{m}/10\ \mu\text{m}$ 级别，这一精度已触及传统减成法无法实现的 IC 载板区间。

在材料性能层面，英伟达 Rubin 系列采用的 M9 级覆铜板将介电损耗（Df）压低至 0.0015 以下，以支撑 224Gbps 超高速信号传输的严苛要求。

3. 国产 PCB 产业链长坡厚雪

印制电路板（PCB）的主要作用是使各种电子零组件形成预订电路的连接。PCB 是电子产品零件装载的基板，为电子元器件提供支撑并提供电气连接，是几乎所有电子设备的基础必需品。国内某头部 PCB 上市公司高管向财联社记者表示，“AI PCB 相关的产品确实需求很好，比如 18 层以上 PCB、高阶 HDI、封装基板的需求也好起来了，如果没有极端情况出现，全球 AI 投资还会持续，高端 PCB 的产品还是会面临比较长的高景气度。”这在行业公司的一季度业绩中已有所体现，多数沾上这波增长红利企业盈利改善明显，净利润实现同比倍增，归因表述中多提及“AI”“业务量增加”等。沙利文中国高级合伙人兼董事总经理贾鹿认为，AI 服务器 PCB 层数持续上行、M9 材料渗透率提升，双重因素叠加推高单板耗针量；供给端，超微径高端钻针的全球产能主要掌握在日系厂商手中，短期难以大幅扩产，供需错配格局为价格提供持续支撑。

3.1. 国产 PCB 产业链量价齐升

印制电路板（PCB）的主要作用是使各种电子零组件形成预订电路的连接。PCB 是电子产品零件装载的基板，为电子元器件提供支撑并提供电气连接，是几乎所有电子设备的基础必需品。既能为电子元器件提供固定装配的机械支撑，实现布线、电气连接或电绝缘，又能保证电气特性。PCB 制造品质，直接关系到电子产品的稳定性、使用寿命，还影响产品整体竞争力，所以被誉为“电子产品之母”。PCB 产

品的分类方式五花八门，行业里常用的分类方法主要有三种，分别是按导电图形层数分类、按板材的材质分类，还有按产品结构分类。

图表 6 PCB 分类

分类依据	类型	特点 / 优势	应用领域
按层数分	单面板、双面板、多层板（含高多层 PCB）	导电图案层数不同； 高多层 PCB 可提供更多走线层，支持复杂密集电路设计，满足高频高速传输需求	高多层 PCB 多用于服务器主板等高端应用
按板材分	刚性板、挠性板、刚挠结合板	刚性板提供支撑； 挠性板可自由弯曲； 刚挠结合板具备一定灵活性	刚性板、挠性板适配不同场景； 刚挠结合板用于折叠式计算设备等特定场景
按产品结构分	厚铜板、HDI 板、高速板、高频板、封装基板、金属基板	厚铜板 ：承载大电流、高电压，散热特性优良； HDI 板 ：高密度布线； 高速板 ：低信号损耗； 高频板 ：高电磁频率； 金属基板 ：散热性能好； 封装基板 ：体积优势明显	厚铜板 ：工业领域； HDI 板 ：消费电子产品； 高速板 ：计算领域； 高频板 ：通讯领域； 金属基板 ：LED 领域； 封装基板 ：芯片领域

资料来源：EDA365 电子论坛公众号，华西证券研究所

PCB 行业产业链呈现“原材料-制造-应用”的三级架构，各环节协同联动且具有显著的技术壁垒与利润分布特征。上游为原材料供应环节，主要包括铜箔）、玻纤布、树脂等基础材料，以及由这些材料加工而成的覆铜板、半固化片、铜球、干膜等核心原材料。中游为 PCB 制造环节，涵盖硬板、软板、刚挠结合板、封装基板等产品的生产。下游则广泛应用于通信、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗设备、航空航天等领域，形成了庞大的终端需求网络。

（一）PCB 产业链上下游

上游原材料环节技术壁垒较高，尤其是覆铜板作为 PCB 的核心基材，其性能直接决定 PCB 的电气、机械及热学特性，对中游产品性能形成关键制约。覆铜板成本占 PCB 生产成本的 30%-40%，其自身成本构成中，铜箔（26.1%）、树脂（26.1%）、玻纤布（19.1%）合计占比达 87.3%，原材料价格波动对覆铜板成本影响显著。由于覆铜板市场集中度较高，而中游 PCB 制造企业集中度相对较低，上游覆铜板企业具备更强的议价能力，可将部分原材料价格压力传导至中游，导致利润向上游集中。

中游 PCB 制造环节因企业数量众多、竞争激烈，且直接材料成本占比近 50%（其中覆铜板占 30%），利润空间易受上游原材料价格波动和下游需求变化的双重挤压。

下游应用环节则凭借终端产品的市场需求主导权，对中游产能结构形成显著拉动，例如通信设备、汽车电子等领域的技术升级需求，推动中游 PCB 企业向高多层板、HDI 板、柔性板等高端产品方向调整产能。这种产业链布局使得上游材料制约与下游需求拉动的相互作用更为显著，成为影响行业发展的核心因素。

图表 7 PCB 产业链全景图



资料来源：EDA365 电子论坛公众号，华西证券研究所

市场增长将呈现显著的结构性特征，高端产品成为核心驱动力。高阶 HDI 板、18 层以上高多层板需求分别增长 14.2% 和 18.5%，而高多层板 ≥ 20 层、HDI 及 IC 载板等高端品类年复合增长率超 25%。中国大陆企业全球高端 PCB 市场份额已从 15% 提升至 30%，高频高速材料、先进封装技术等领域年均增速超 10%，推动产业从配套角色向“科技基石”升级。

（二）上游抬高价格，PCB 量价齐升

另外，今年以来，PCB 行业进入涨价周期，呈现量价齐升、订单饱满、交期拉长的高景气格局。5 月份以来，行业迎来新一轮集中提价，上游覆铜板、高端铜箔、电子布及特种树脂等原材料价格继续上行，带动 PCB 成品价格同步走高。其中，面向 AI 算力的高速高频产品涨幅领先，交期普遍拉长至数月。

根据财联社，高阶 CCL 通常是面对高速、高频应用研发的先进覆铜板材料，具备低介电常数、超低介质损耗因子、高耐热性等特性，常采用低损耗树脂与高模量玻璃纤维布，适用于 AI 服务器、5G/6G 基站、车载雷达和卫星通信等对信号完整

性和散热要求极高的场景。根据台光电去年 10 月法人说明会的数据，2024-2027 年高端 CCL 市场预计将以 40% 的 CAGR 加速发展，增速高于 2018-2021 年 21% 的 CAGR。为紧抓景气周期红利，多家上市公司实施再融资事项，资金主要投向于高阶 CCL。据了解，高端 CCL 根据信号传输性能可分为 M7/M8/M9 等不同规格，市场主流厂商竞相布局此类产品。

随着覆铜板 CCL 全面涨价各大厂商相应调价，全球电子铜箔也正进入高端产品（HVLP 系列/RTF 系列）上涨、各类铜箔产品价格普遍上涨、加工费持续上行的行业周期。国外企业以三井、古河、Resonac、三菱等领涨，国内以铜冠铜箔、德福科技、诺德股份等跟涨，锂电铜箔和电子电路铜箔双双涨价，加工费普遍上调 1500-5000 元/吨，部分高端产品涨价幅度超 30%，这背后的核心驱动是 AI 算力硬件爆发和高端产能不足，供需呈现“高端短缺、中端偏紧、低端平衡”的结构性格局。

总体来说，2026 年供需缺口比 2025 年更大，尤其在 AI 算力硬件需求背景下，RTF 和 HVLP 高端铜箔供不应求，同时在新能源大力发展背景下极薄锂电铜箔需求也较大，市场总体需求增加 25-30 万吨，但全行业新增产能仅约 10 万吨。国际方面，在 2025 年其 HVLP4 等高端铜箔累计已提价 15%，今年 4 月起全系加工费涨 2 美元/磅（约 1.4 万元/吨），预计后续高端产品会持续涨价。国内龙头企业对 HVLP、RTF 等高端产品年内预计 2-3 轮涨价，累计约超 20%-30%，锂电铜箔第二季度开始第一轮涨价（1500-2000 元/吨）。

（三）PCB 产业链带动设备出货量

PCB 钻针是 PCB 钻孔工序中的核心工具，其能力和品质直接决定了电路板的精度、可靠性与性能上限。算力 PCB 以高多层 PCB、高阶 HDI 为主，性能要求更高，缩短钻针寿命并推升钻针消耗与需求，且基材迭代倒逼钻针升级，驱动钻针量价齐升。

图表 8 鼎泰高科华南总部（二期）项目正式投产



资料来源：厚街视界公众号，华西证券研究所

利

用钻针进行钻孔是 PCB 生产过程中一道关键工序，钻出的微孔用于实现不同电路层间信号传输，因此对钻针的精密度和耐磨性有较高要求。

在需求端，一方面，服务器迭代升级使 PCB 板厚度持续提升，加工 8mm 板单孔需使用 4 支不同长度钻针，带动钻针需求量增加。另一方面，以 GB200、NVL72 为代表的新一代 AI 服务器，PCB 层数已从传统服务器的 12 至 16 层跃升至 24 至 40 层，单板耗针量显著上升；同时，夹层材料升级为 M9 (SiO2 含量达 99.99%)，其硬脆特性导致钻针加工寿命从 1000 孔骤降至 200-300 孔，更换频率进一步提升。

新锐股份人士向财联社记者表示“今年钻针价格已普遍上涨，去年 9 毛 5 的普通钻针现在涨到 1 块 2 左右，涨幅在 20%以上，部分高端型号的钻针今年价格涨幅甚至达 35%以上。”

由于高端钻针需要高精度硬质合金基材、精密涂层工艺与严苛的微孔尺寸一致性控制，制造壁垒远高于传统产品，因此 30 倍以上长径比的高端产品价格涨幅更高。

鼎泰高科证券部工作人员表示，今年 4 月末钻针的产能已达 1.4 亿支，目前满产满销，公司扩产速度为月增 1000 万支，该推进节奏实际还未能跟上市场的需求。A 股上市公司相关负责人向财联社记者坦言“这一两年，钻针市场供应仍将较为紧俏。”

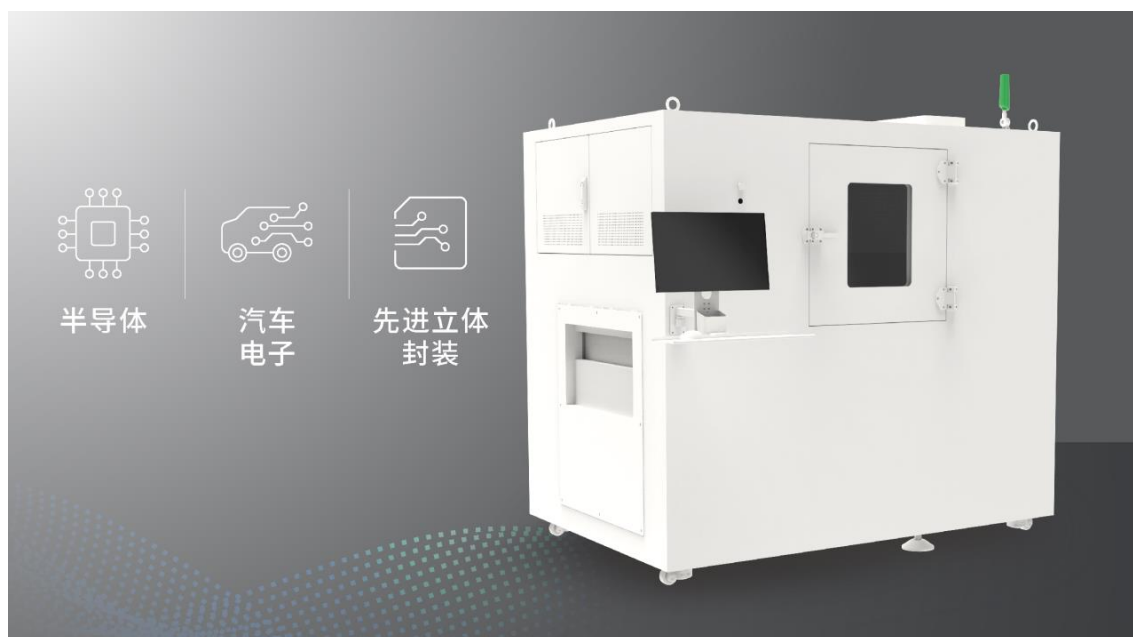
沙利文中国高级合伙人兼董事总经理贾庞认为，AI 服务器 PCB 层数持续上行、M9 材料渗透率提升，双重因素叠加推高单板耗针量；供给端，超微径高端钻针的全球产能主要掌握在日系厂商手中，短期难以大幅扩产，供需错配格局为价格提供持续支撑。

在 PCB 制造过程中，检测设备承担着至关重要的质量把关作用。随着电子产品向高密度、高频化方向发展，PCB 检测技术也在不断升级迭代。PCB 生产有三种检测场景：1. 光学检测类设备：自动光学检测设备 (AOI) 是现代 PCB 产线的标配设备。它采用高分辨率 CCD 相机配合先进图像算法，可快速识别线路断路、短路、焊盘缺失等表面缺陷。最新一代 AOI 设备已实现 3D 检测功能，能精确测量线路厚度和焊点形态，检测精度可达 10 微米级别。典型应用场景包括内层图形转移后的初检和成品终检。2. 电气性能测试设备：飞针测试仪以其灵活性著称，采用可编程移动探针，无需制作专用治具即可完成导通测试。最新机型测试速度可达 5000 点/分钟，支持 4 线制 Kelvin 测试，接触电阻测量精度达 0.1mΩ。特别适合样板验证和小批量多品种生产场景。3. 环境可靠性测试设备：热成像系统通过红外焦平面探测器，可实时捕捉电路板温度场分布。温度分辨率达 0.05℃，空间分辨率 40 μm，能精准定位过热元件。在电源模块测试中，可快速发现布局不合理或散热不良的设计缺陷。

奕瑞科技推出的面向先进封装与多层电路板的平面 CT 检测系统，依托从核心部件到算法的全链路自研优势，不仅能精准锁定 TGV、微盲孔、背钻

孔等深层缺陷，更以无损透视与高效运转，为高端半导体制造全链条提供硬核的质量保障。

图表 9 奕瑞科技平面 CT 检测系统



资料来源：奕瑞科技公众号，华西证券研究所

日联科技已发布纳米级智检装备，针对极高检测标准，搭载自研 160kV 微聚焦 X 射线源，支持 2000 倍放大，可清晰呈现纳米级内部缺陷，结合 AI 智能诊断，灵活满足芯片封装及先进元器件等场景的极致检测需求。专为精密半导体检测打造，160kV 轻松穿透异质材料，对先进封装中的晶圆凸块桥接、芯片冷焊及 MEMS 制造空洞等关键缺陷进行 AI 自动检测。日联科技自研微焦点射线源已实现全谱系覆盖，构建起从毫米级 PCB、微米级芯片到纳米级互连的全尺度、穿透式质量洞察体系。

图表 10 日联科技纳米级智检装备



资料来源：日联科技公众号，华西证券研究所

PCB 产业链的爆发，关键 PCB 生产环节（曝光、压合、钻孔、成型及检测）设备更换需求激增。这一趋势正持续扩大 PCB 专用设备市场。全球 PCB 专用设备市场规模从 2020 年的约 58.40 亿美元增至 2024 年的约 70.85 亿美元，CAGR 为 4.9%，预计到 2029 年将达到约 113.88 亿美元，2025-2029 年 CAGR 为 8.6%。作为全球 PCB 行业的重要组成部分，中国 PCB 专用设备行业市场规模从 2020 年的约 33.06 亿美元增至 2024 年的约 41.11 亿美元，2020-2024 年 CAGR 为 5.6%，预计 2029 年达到约 64.95 亿美元，2025-2029 年 CAGR 为 8.2%。

日联科技电子半导体 X-Ray 检测装备主要应用于 BGA、IGBT、Flip Chip 等 IC 芯片半导体以及 PCBA 元器件焊接、LED、光伏等行业的高精密检测。

3.2. 投资建议

受益标的：

PCB 制造：胜宏科技、沪电股份、深南电路、鹏鼎控股、东山精密、景旺电子、广合科技；

材料：生益科技、宏和科技、金安国纪、南亚新材；

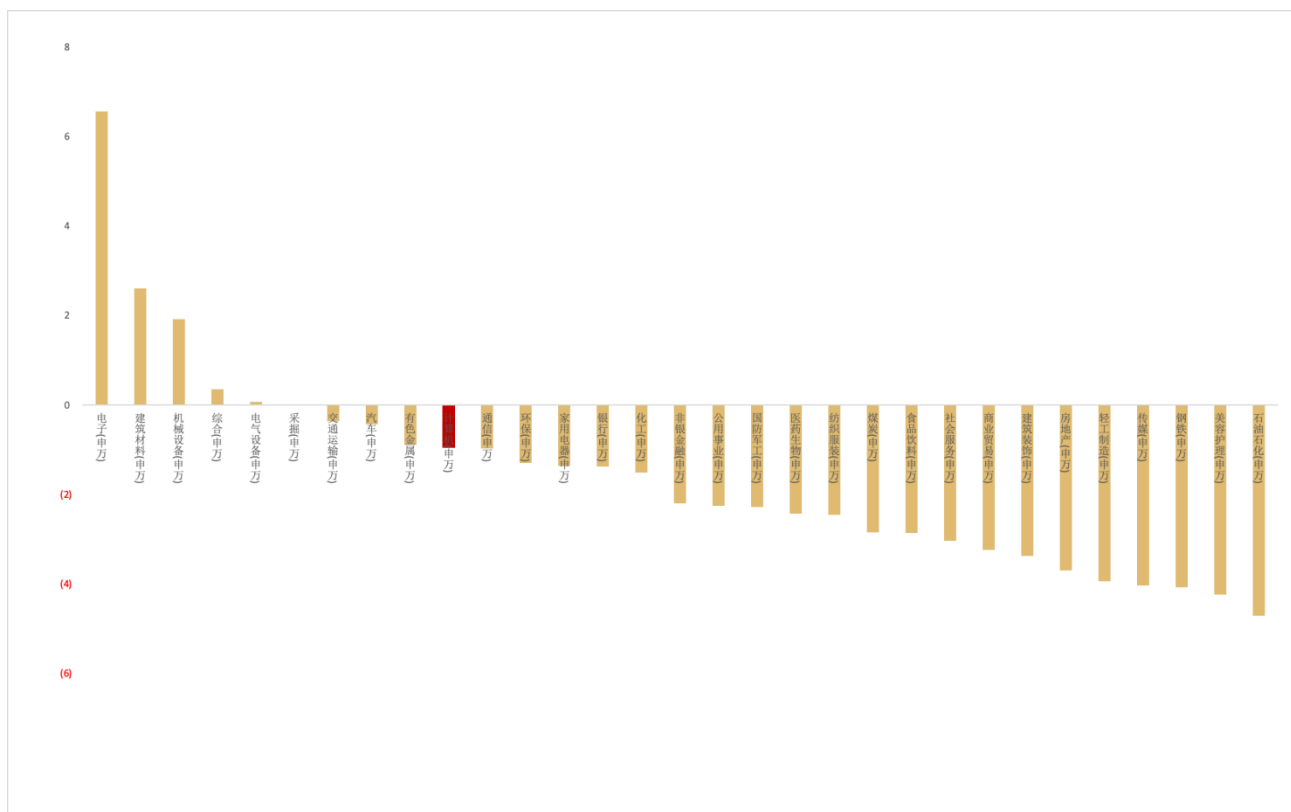
设备耗材：鼎泰高科、大族数控、东威科技、芯碁微装、天承科技；
PCB 检测设备：奕瑞科技，日联科技。

4. 本周行情回顾

4.1. 行业周涨跌及成交情况

本周市场计算机位列第10位。本周沪深300指数下跌0.298%，申万计算机行业周跌幅0.96%，低于指数0.66个pct，在申万一级行业中排名第10位。

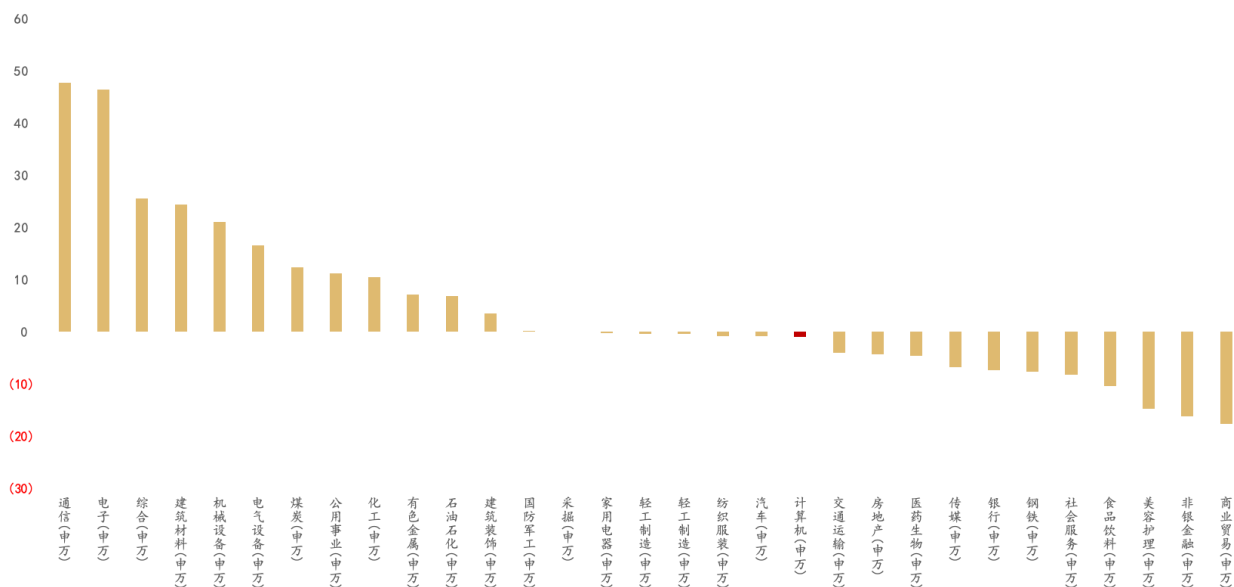
图表 11 申万一级行业指数涨跌幅（%）（本周）



资料来源：Wind，华西证券研究所

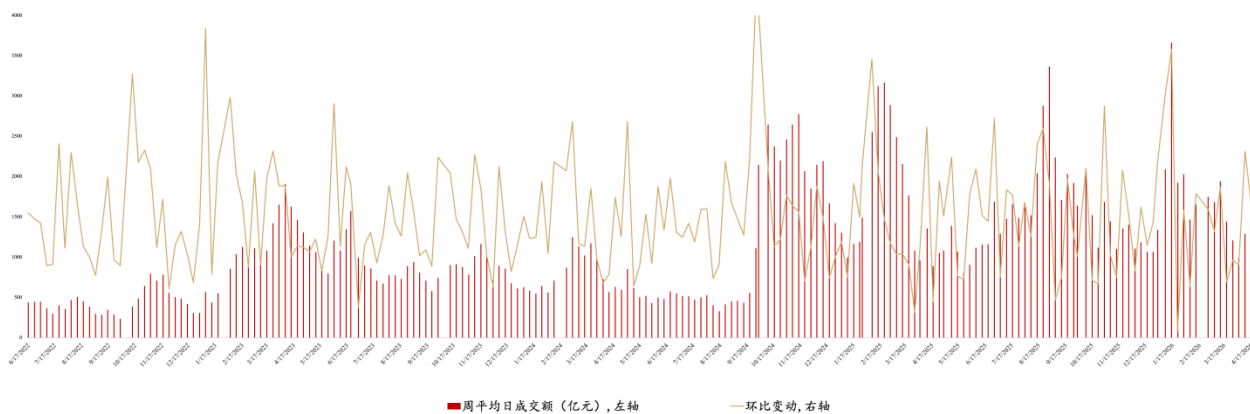
2026年初至今申万计算机行业涨幅在申万一级31个行业中排名第20名。年初至今申万计算机行业累计下跌1.02%，在申万一级31个行业中排名第20位，沪深300上升4.65%，低于指数5.67个百分点。

图表 12 申万一级行业指数涨跌幅(%) (2026 年初至今)



资料来源: Wind, 华西证券研究所

图表 13 计算机行业周平均日成交额 (亿元)

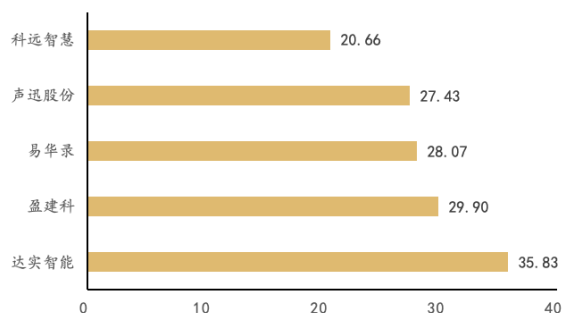


资料来源: Wind, 华西证券研究所

4.2. 个股周涨跌、成交及换手情况

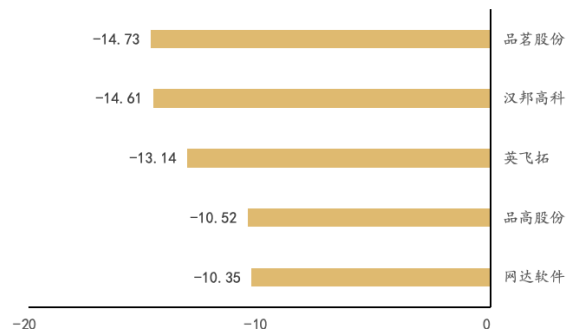
本周计算机板块下跌。321 只个股中, 95 只个股上涨, 201 只个股下跌, 25 只个股持平。上涨股票数占比 29.60%, 下跌股票数占比 62.62%。行业涨幅前五的公司分别为: 达实智能、盈建科、易华录、声迅股份、科远智慧。跌幅前五的公司分别为: 品茗股份、汉邦高科、英飞拓、品高股份、网达软件。

图表 14 申万计算机行业周涨幅前五(%) (本周)



资料来源: Wind, 华西证券研究所

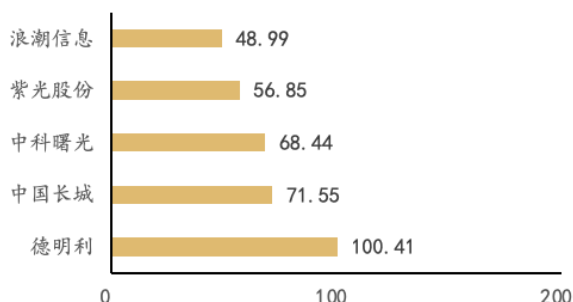
图表 15 申万计算机行业周跌幅前五(%) (本周)



资料来源: Wind, 华西证券研究所

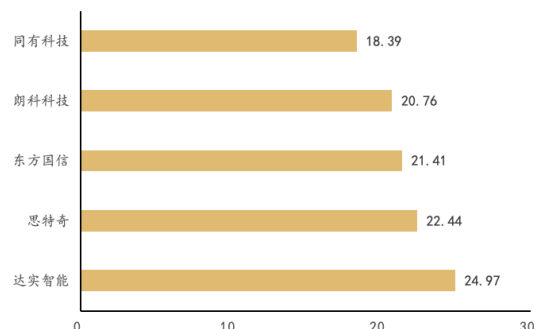
从周成交额的角度来看, 德明利、中国长城、中科曙光、紫光股份、浪潮信息位列前五。从周换手率的角度来看, 达实智能、思特奇、东方国信、朗科科技、同有科技位列前五。

图表 16 申万计算机行业周成交额前五(亿元)



资料来源: Wind, 华西证券研究所

图表 17 申万计算机行业周均换手率前五(%)



资料来源: Wind, 华西证券研究所

4.3. 核心推荐标的行情跟踪

本周板块整体呈现普遍下跌的情况下, 从 8 只核心推荐标的来看, 5 只个股下跌, 3 只个股上涨。其中, 跌幅最大的为用友网络, 跌幅为 5.56%; 涨幅最大的为中科创达, 涨幅为 10.69%。

图表 18 本周核心推荐标的行情

序号	股票代码	公司简称	总市值 (亿元)	收盘价 (元)	周涨跌幅 (%)	日均成交额 (亿元)	换手率 (%)
1	300674.SZ	宇信科技	127.15	18.06	-2.27	1.92	1.49
2	002230.SZ	科大讯飞	1137.38	47.35	0.45	24.49	2.31
3	300682.SZ	朗新科技	153.86	14.27	-1.65	3.56	2.32
4	600570.SH	恒生电子	489.13	25.83	-1.07	7.97	1.59
5	300454.SZ	深信服	499.70	115.79	-3.52	14.85	4.31
6	600588.SH	用友网络	371.43	10.87	-5.56	5.48	1.42
7	688083.SH	中望软件	102.31	60.31	5.75	3.02	2.93
8	300496.SZ	中科创达	330.14	71.65	10.69	18.45	7.19

资料来源：Wind，华西证券研究所

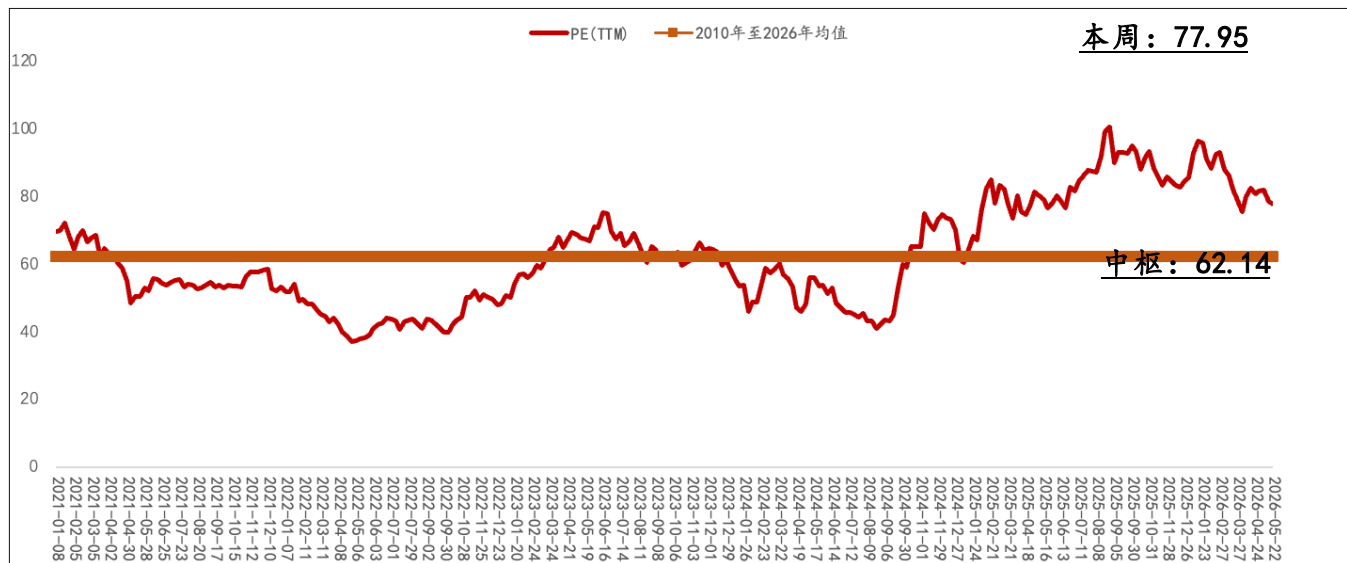
注：

- 1、 区间收盘价指本周最后一个交易日的收盘价，复权方式为前复权。
- 2、 朗新科技为华西计算机 & 通信联合覆盖

4.4. 整体估值情况

从估值情况来看，SW计算机行业PE(TTM)从2018年低点37.60倍升至77.95倍，2010-2026年历史均值62.14倍，行业估值高于历史中枢水平。

图表 19 申万计算机行业估值情况（2010 年至今）



资料来源：Wind，华西证券研究所

5. 本周重要公告汇总

思特奇：关于提前赎回思特转债的第七次提示性公告

公司再次提示将提前赎回“思特转债”，赎回日为 2026 年 5 月 29 日，赎回价格为 102.90 元/张，5 月 26 日起停止交易，5 月 29 日起停止转股，5 月 28 日收市后仍未转股的债券将被强制赎回并最终摘牌；由于二级市场价格与赎回价格存在较大差异，未及时转股的持有人可能面临损失。

安博通：2025 年年度权益分派实施公告

公司实施 2025 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，股权登记日为 2026 年 5 月 22 日，除权日及新增股份上市日为 2026 年 5 月 25 日；转增后公司总股本由 7718.50 万股增至 1.08 亿股，本次资本公积转增不涉及扣税。

星环科技：关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告

持股 5%以上股东林芝利创信息技术有限公司在 2026 年 4 月 9 日至 5 月 18 日期间通过集中竞价减持，公司持股比例由 6.29%降至 6.00%，触及 1%刻度披露标准；本次变动属于此前已披露减持计划的执行，不触发要约收购，不会导致公司控制权变化，也不会对公司治理和持续经营产生重大影响。

国投智能：关于持股 5%以上股东减持股份比例触及 1%整数倍的公告

持股 5%以上股东李国林因个人资金需求，于 2026 年 3 月 20 日至 5 月 17 日通过集中竞价减持 160.66 万股，占公司总股本 0.1869%，持股比例由 7.1840%降至 6.9970%，触及 1%整数倍披露标准；本次减持未超过此前披露的计划上限，李国林仍为公司 5%以上股东，不影响公司控制权、治理结构和持续经营。

正元地信：关于召开 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩说明会的公告

公司将于 2026 年 5 月 27 日 10:00—11:00 通过上证路演中心召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，采用网络文字互动方式，就 2025 年年度及 2026 年一季度经营成果、财务状况和投资者关注问题进行交流；投资者可在 5 月 20 日至 5 月 26 日 16:00 前通过上证路演中心或公司邮箱提前提问。

泛微网络：关于召开 2026 年第一季度业绩说明会的公告

公司将于 2026 年 5 月 27 日 16:00—17:00 通过上证路演中心召开 2026 年第一季度业绩说明会，重点说明一季度经营成果和财务状况，并在信息披露允许范围内回应投资者普遍关注的问题；投资者可于 5 月 20 日至 5 月 26 日 16:00 前通过上证路演中心或公司邮箱预先提交问题。

金桥信息：2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会会议记录

公司 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会披露，2025 年实现营业收入 6.93 亿元，同比下降 0.94%，归母净利润亏损 5715.65 万元但同比减亏；2026 年一季度营业收入 1.21 亿元，同比增长 19.32%，归母净利润亏损 3046.02 万元。公司因 2025 年度亏损及 2026 年经营资金需求，拟不分红；定增事项已获证监会注册批复，批复有效期为 12 个月。

达梦数据：2025 年年度权益分派实施公告

公司实施 2025 年度权益分派，以总股本 1.1324 亿股为基数，每股派发现金红利 1.00 元，合计派发现金红利 1.1324 亿元；股权登记日为 2026 年 5 月 25 日，除权除息日和现金红利发放日均为 2026 年 5 月 26 日，本次分红不涉及差异化分红送转。

上海钢联：关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告

公司于 2026 年 5 月 18 日召开了 2025 年年度股东会，完成了第七届董事会的换届选举。高级管理人员及证券事务代表聘任情况：总裁：高波，副总裁：夏晓坤、任竹倩、顾敏华、陈陈、刘静、张勇、王深力、李勇胜，董事会秘书：李勇胜，财务负责人：李凤芹，证券事务代表：谢芳。

ST 信源：关于控股股东部分股份补充质押的公告

公司控股股东林皓先生近期将其持有的部分股份办理了补充质押。补充质押的股份

数量为 10,000,000 股，占其所持股份比例为 4.55%，占公司总股本比例为 0.69%。

皖通科技：关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 186 名，可解除限售的限制性股票数量为 7,580,900 股，占公司目前总股本比例为 1.7695%

新致软件：2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）

本文件为公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书注册稿，本次发行对象为实际控制人郭玮及其控制的乾耀迦晟，发行价格经除息调整后为 9.57 元/股，发行数量不超过 3134.80 万股，拟募资不超过 3 亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还贷款；本次发行构成关联交易，但不会导致实际控制人变化。

多伦科技：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

公司此前使用闲置募集资金购买的 3 笔保本浮动收益型结构性存款已到期赎回，合计本金 2.05 亿元，实际收益 139.23 万元；截至公告日，公司授权期内募集资金现金管理本金已全部收回，尚未收回本金为 0，未超过董事会批准额度。

三未信安：2025 年年度权益分派实施公告

公司实施 2025 年度权益分派，以扣除回购专户股份后的可参与分配股本为基数，向全体股东每股转增 0.48 股，不派发现金红利、不送红股；股权登记日为 2026 年 5 月 26 日，除权日及新增股份上市日为 2026 年 5 月 27 日，本次资本公积转增不涉及扣税。

方直科技：2025 年度分红派息实施公告

公司实施 2025 年度分红派息方案，以扣除回购专户股份后的 2.51 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元，合计派发约 626.89 万元，不进行资本公积转增股本；股权登记日为 2026 年 5 月 26 日，除权除息日为 2026 年 5 月 27 日。

直真科技：关于控股股东、实际控制人部分股份质押及部分股份解除质押的公告

公司控股股东、实际控制人王飞雪办理部分股份质押及解除质押：新增质押 164 万股，占其持股 6.58%、占公司总股本 1.37%；同时解除质押 285.99 万股。变动后，王飞雪累计质押 374 万股，占其持股 15.02%、占公司总股本 3.13%；公司称相关质押风险可控，不会导致控制权变更。

浩瀚深度：2025 年年度股东会决议公告

公司 2025 年年度股东会已召开，出席股东及代理人共 51 名，代表表决权比例 45.84%；会议审议通过了 2025 年度董事会工作报告、利润分配方案、2026 年度董事薪酬、续聘 2026 年度审计机构及修订董事和高级管理人员薪酬管理制度等议案，本次会议无被否决议案。

合合信息：上海合合信息科技股份有限公司关于独立董事任期满六年辞任的公告

江翔宇先生与王少飞先生因连续任职时间即将满六年，申请辞去公司第二届董事会独立董事及专门委员会相关职务。

航天信息：航天信息股份有限公司关于选举职工董事的公告

公司于 2026 年 5 月 19 日召开职工代表大会，进行职工董事的民主选举。李慧敏先生被选举为公司第九届董事会职工董事。李慧敏拥有工商管理硕士学位，研究员职称，曾在中国航天工业总公司三院三十一所担任助理工程师。

永信至诚：简式权益变动报告书

本次权益变动是由于分红转增和基于自身资金需求通过询价转让方式减持股份，导致权益比例变动。本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人合计持有永信至诚 24,082,000 股，占总股本的 51.42%。本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人合计持有永信至诚 72,785,183 股，占总股本的 48.21%。

中科信息：关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告

公司发布关于部分董事及高级管理人员计划减持股份的预披露公告。公告内容基于董事付忠良和高级管理人员刘小兵提交的《拟减持本公司股份的意向告知函》。付忠良：公司董事，持有股份 2,352,466 股，占公司总股本的 0.79%。刘小兵：公司董事会秘书，持有股份 580,000 股，占公司总股本的 0.20%。

6. 本周重要新闻汇总

长鑫科技：一季度营收同比增长 719.13% 净利润 330 亿元

长鑫科技科创板 IPO 招股说明书（申报稿）显示，2026 年 1-3 月，受全球算力需求持续增长、全球主要厂商产能调配等因素影响，全球 DRAM 产品供不应求。2026 年 1-3 月，公司营业收入 5,080,014.55 万元，同比增长 719.13%；净利润 3,301,152.51 万元；归属于母公司所有者的净利润 2,476,203.15 万元；扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润 2,634,078.41 万元。

（来源：财联社）

国产 DDR5 颗粒大批进入供应链！中国内存厂商加紧生产：稳定供货

全球内存行业正处于 AI 驱动的历史性上行周期，国产 DRAM 产业迎来关键发展窗口。随着国内龙头存储芯片企业长鑫存储（CXMT）DDR5 技术取得实质性突破，中国内存模组厂商正全面加速下游产品落地，推动国产 DDR5 从技术验证阶段大规模进入消费与企业级商用市场。

（来源：快科技）

中国电信推出试商用 Token 套餐

中国电信推出系列试商用 Token 套餐：面向开发者及中小微企业客户，推出三档 Token Plan 以及宽带上行提速包和安全防护包两种可选包服务，最低每月资费 39.9 元，提供 1500 万 tokens；面向个人及家庭客户，推出三档 Token Plan 以及宽带上行提速包和安全防护包两种可选包服务，最低每月资费 9.9 元，提供 1000 万 tokens。

（来源：科创板日报）

无锡将建立一座大规模“Token 工厂”

弘信电子联手无锡高新区打造的江苏省内首个华为昇腾 384 超节点算力集群，签约落户无锡。以华为超节点算力集群为首期基础设施，弘信电子将在无锡建立一座大规模“Token 工厂”。这将成为规模化、高性能“国芯国模”算力集群新样板。此次落地无锡高新区的“Token 工厂”，首批将部署 4 台华为昇腾 384 超节点服务器，每套超节点服务器拥有 384 卡算力规模，把 4 个 384 张 GPU 连成一个超级集群。

（来源：科创板日报）

摩尔线程与国家具身智能应用中试基地签署战略合作协议

在杭州市具身智能创新发展大会上，国家人工智能应用中试基地（具身智能）

（简称：国家具身智能应用中试基地）正式揭牌，摩尔线程成为共建合伙人，并担任其产业委员会委员。此外，摩尔线程与国家具身智能应用中试基地签署战略合作协议，并成立“具身智能算力与仿真联合实验室”。

（来源：快科技）

韩国将投入超 1 亿美元扶持中小企业，覆盖半导体产业

韩国政府周日宣布，将投入 1700 亿韩元（约合 13 亿美元），扶持生产高端战略材料、零部件及装备的中小企业。此次扶持范围同时覆盖尖端半导体及相关产业。韩国产业部表示，该扶持项目旨在助力优质中小配套企业生产高科技产业链稳定运转所需的核心材料与战略物资，项目申报截止日期为 7 月 17 日。

（来源：新浪财经）



贝莱德考虑对 SpaceX 首次公开募股投资数十亿美元

贝莱德已讨论在下个月对 SpaceX 公开募股（IPO）投资 50 亿至 100 亿美元。这笔巨额投资对应的 IPO 募资规模最高可达 750 亿美元，将代表这家全球最大资产管理公司对马斯克旗下企业投下重要信任票。

（来源：新浪财经）

OpenAI 与马耳他达成协议，所有马耳他民众都能使用 ChatGPT Plus

美国人工智能公司 OpenAI 周六表示，已与马耳他政府签署协议，所有居民在完成使用 AI 培训课程后，均可免费使用其 ChatGPT Plus 服务一年。该项目将于 5 月启动，随着更多马耳他居民完成这门免费课程，服务规模预计将逐步扩大。该计划也将向旅居海外的马耳他公民开放。

（来源：新浪财经）

腾讯自研 AI 设计智能体 Ardot 公测：生成可编辑设计稿

腾讯云宣布，腾讯自研 AI 设计智能体平台 Ardot 正式公测，现在注册即可获得 1000 Credits 免费额度。Ardot 的核心思路是让 AI 生成的每一张图片、每一个界面，都成为可编辑、可复用、可交付的团队资产。Ardot 支持调用团队自有业务组件库，可一键生成符合团队设计规范的可编辑稿。

（来源：快科技）

外骨骼机器人公司极壳科技完成 3.4 亿元 B+轮融资

外骨骼机器人公司极壳科技宣布完成 5000 万美元（约合 3.4 亿元人民币）B+轮融资，由蚂蚁集团和美国龙珠领投，Sofina、Granite Asia 跟投，高鹄资本担任独家财务顾问。去年 11 月，极壳科技完成 7000 万美元 Pre B 及 B 轮融资，投资方包括光合创投、五源资本美国龙珠、Monolith、五源资本、IDG 资本、红杉中国等。至此，极壳科技已完成 1.2 亿美元 B 轮系列融资。

（来源：科创板日报）

上海电信联合华为等推出战略级家庭智能产品“AI 家庭助手”

上海电信携手华为等产业合作伙伴，推出战略级家庭智能产品——AI 家庭助手，该产品基于华为智能业务平台 AISF，包含视听娱乐、相册回忆、健康康养、家居控制、网络诊断等应用场景。在便民生活领域，AI 家庭助手与淘宝闪购合作，依托大模型识别用户点餐意图，实现周边门店检索、热门新品推荐，同时打通支付宝免密支付。

（来源：科创板日报）

灵童机器人发布新一代桌面人形机器人，启动 1000 台全球共创计划

上海灵童机器人正式启动社区共创活动，宣布面向全球专业用户免费发放 1000 台桌面人形机器人，可用于二次开发与内容共创。灵童最新发布的桌面机器人“念”高度约 60 厘米，内部集成 30 个自研毫米级力矩关节舵机，具备 30 个自由度，可完成站立、行走、转身、蹲起及舞蹈动作。

（来源：36 氪）

英伟达领投：印度 AI 公司 Simplismart 融资 2000 万美元

英伟达正处于高级谈判阶段，准备领投印度生成式人工智能公司 Simplismart 价值 2000 万美元（注：现汇率约合 1.36 亿元人民币）的融资轮，该公司估值约为 1 亿美元。此举标志着英伟达正在加大对印度新兴 AI 基础设施生态系统的投入。

（来源：IT 之家）

Netflix 成立 AI 工作室 INKubator，发力生成式动画短片

Netflix 正在组建一个名为 INKubator 的全新内部工作室，旨在利用人工智能制作短篇动画内容。根据最近发布的若干职位列表，这家流媒体巨头正在为 INKubator 招募各种职位的员工，包括制片人、软件工程师和 CG 艺术家。INKubator 的长期技术战略将专注于“由生成式人工智能驱动的工作流、艺术家工具，以及可扩展、安全的多剧集环境”，这表明该项目远非一次性实验。

（来源：IT 之家）

Akamai 拟收购 LayerX，五年完成四项网络安全收购

Akamai Technologies 宣布已就收购 LayerX 达成最终协议。LayerX 是基于浏览器的 AI 使用管控及安全企业浏览器 (SEB) 领域的领先技术提供商。借助 LayerX 的解决方案，Akamai 的保护范围将扩展到浏览器层面。通过此次收购，Akamai 在其 Zero Trust 安全产品组合的演进中迈出了关键一步，并着手应对 2026 年安全领域负责人最紧迫的优先事项之一：AI 使用管控。

（来源：TechWeb）

总投资 794.6 亿元！印度首座 300 毫米晶圆厂获 ASML 设备支持

全球半导体设备巨头 ASML 与印度塔塔电子正式签署谅解备忘录，将为印度古吉拉特邦多莱拉正在建设的 300 毫米/12 英寸晶圆厂部署光刻设备。该工厂是印度首座商业前端半导体制造厂，总投资额达 110 亿美元（约合人民币 794.6 亿元）。本次合作不仅涵盖核心光刻工具的供应，还包括人才培养和供应链支持。

（来源：快科技）

三大运营商齐上线 Token 套餐：AI 算力像话费一样包月

中国电信率先推出全国性试商用 Token（词元）套餐，最低月租 9.9 元。紧随其后，中国移动、中国联通陆续上线同类服务，国内三大运营商正式全员入局，将 AI 算力包装成类似流量包的包月产品，用户可直接话费支付，便捷跨平台使用。

（来源：快科技）

历史性转折！英伟达中国份额暴跌至 8%，国产 AI 芯片原创架构突围市占破 60%

中国 AI 芯片市场正迎来一场历史性的权力交接。据 Bernstein Research 等多家机构最新预测，英伟达在中国 AI 芯片市场的份额已从三年前的绝对垄断地位（95%）暴跌至如今的 8%。与之形成鲜明对比的是，国产 AI 加速卡市场份额强势突破 60%，国产化率首次站上六成大关。这意味着，国产 GPU 已正式撕掉“追随者”标签，重塑市场格局。

（来源：TechWeb）

全球车端算力之王！小鹏 GX 首台 Robotaxi 量产车下线：搭载 4 颗自研图灵 AI 芯片

小鹏汽车官方正式宣布，基于旗舰车型 GX 打造的首台 Robotaxi 量产车顺利下线，标志着中国 L4 级自动驾驶商业化进程迎来加速。小鹏汽车官微发布，该车型是中国首款全栈自研、前装量产的 Robotaxi，该车同时也是国内首个采用纯视觉方案实现 L4 级自动驾驶的量产车型。

（来源：快科技）

矩阵超智发布 MATRIX-3 全能旗舰级人形机器人

矩阵超智正式发布 MATRIX-3 全能旗舰级人形机器人，MATRIX-3 身高 170cm、体重 65kg，搭载 WAVE 物理基座模型。同时，矩阵超智宣布 MATRIX-3 系列正式面向全球发售。

（来源：36 氪）

苹果丧失芯片议价特权！AI 服务器跨界抢芯，2026 年 DRAM 价格恐暴涨 194%

由于 AI 服务器跨界抢夺消费级内存，苹果不仅失去了单独协商价格折扣的特权，更被迫以远高于预期的价格大批量采购芯片。受 AI 服务器持续抽血影响，预计 2026 年 DRAM 价格将同比暴涨 194%，NAND 闪存价格更将同比飙升 244%。

（来源：TechWeb）

苹果英特尔代工联手仅为“试水”！机构力挺台积电：真 2nm 独家护城河难撼

针对近期苹果与英特尔达成芯片代工协议引发的行业担忧，伯恩斯坦法兴集团最新研报定调：这一合作不会对台积电构成实质性威胁，台积电在全球先进制程的核心地位依然稳固。

（来源：TechWeb）

Meta 加速转型重组：约 7000 人转岗 4 个 AI 部门

Meta 公司正同步推进裁员和内部转岗，按 2025 年底约 78000 名员工计算，影响了大约 20% 的员工。在裁员之外，最新消息称 Meta 公司正在推进内部转岗，公司人力资源负责人 Janelle Gale 已通知员工，约 7000 人将被调入 4 个新的 AI 组织。

（来源：IT 之家）

英伟达 Vera CPU 交付即爆单 甲骨文承诺部署数十万颗

英伟达宣布，其首款专为 Agentic AI（智能体 AI）设计的 CPU——Vera，已完成对 Anthropic、OpenAI、SpaceX AI 及甲骨文云的首批交付。甲骨文产品管理负责人卡兰·巴塔透露：“甲骨文云基础设施（OCI）计划从 2026 年开始部署数十万颗英伟达 Vera CPU。”

（来源：快科技）

阿里发布新一代千问旗舰模型 Qwen3.7-Max，登顶最佳国产模型

在 2026 阿里云峰会现场，阿里巴巴发布全新一代千问旗舰模型 Qwen3.7-Max，在三方机构 Arena 全球大模型盲测总榜中，Qwen3.7-Max 超过 Kimi-K2.6、DeepSeek-v4-pro、GLM-5.1，与 GPT、Claude、Gemini 最强模型接近，位列国产模型第一。在一个全新的芯片平台上，Qwen3.7-Max 通过自主编程和超 1000 次工具调用，实现了一个关键内核的自我进化，推理速度较原版本提升 10 倍。

（来源：TechWeb）

字节 Seedance 2.1 模型即将发布，系列已狂揽 AI 视频生成 80% 算力消耗

字节跳动正准备发布 Seedance 2.1 模型，这是其 AI 视频生成模型的更新版本，据知情人士透露，2.1 的生成质量比当前 2.0 版本提升了 20%，提升主要来自时间一致性的进步，以及生成场景物理模拟的改进。若按日均算力消耗占比测算，Seedance 已

狂揽超 80% 的市场份额，紧随其后的可灵约占 14%，万相 2.7 约占 4%，而 HappyHorse 的份额则已不足 1%。

（来源：IT 之家）

飞猪推出酒店商家智能助理

飞猪正式推出酒店商家智能助理，向平台上所有酒店免费开放。商家智能助理“上岗”后，一句话即可指挥 AI 批量调房态、改库存、录发票。它还能进行实时数据分析，向酒店提出科学的价格和库存管理策略参考；发现入住全流程中的服务关键点，帮助酒店优化服务，入住前主动关怀、离店后经营口碑。

（来源：36 氪）

正式对标美国最强编程巨头，DeepSeek 亲自下场做 Claude 竞品

DeepSeek 资深研究员证实，公司正组建全新 Harness 团队，研发对标 Anthropic Claude Code 的官方编程 Agent 产品 DeepSeek Code Harness。此前 DeepSeek 已开放相关核心岗位招聘，并将 Harness 定义为涵盖上下文管理、工具调用等模型外工程动作的核心模块。第三方曾推出口碑不错的开源 DeepSeek-TUI，但无法替代官方产品。DeepSeek 预计 6 月推出 V4.1 升级版，重点提升 AI 编程能力，届时该编程 Agent 有望问世。

（来源：快科技）

谷歌发布旗舰多模态大模型 Gemini Omni 可实现“任意输入、任意输出”能力

谷歌发布全新旗舰多模态大模型 Gemini Omni，主打“任意输入、任意输出”能力，打破模态割裂，实现文本、图像、音频、视频全模态互通理解与生成。该模型依托 Genie 世界模型、Nano Banana 图像模型、Veo 视频生成模型三大技术底座，支持多样化混合输入；最大亮点是对话式实时编辑，可通过自然语言迭代优化生成内容且不破坏原有逻辑与物理效果，现场已演示手绘+文字指令生成带物理碰撞的特效视频。

（来源：TechWeb）

谷歌最强模型 Gemini 3.5 Flash 发布：速度快 4 倍，干翻 GPT-5.5

谷歌推出 Gemini 3.5 Flash 并面向全球所有用户免费开放。该模型是谷歌迄今最强的智能体与编程模型，性能接近大型旗舰级，在 Terminal-Bench 2.1、MCP Atlas、CharXiv Reasoning 等多项基准测试中全场第一，全面超越上代旗舰 Gemini 3.1 Pro。其输出速度超 280token/秒，是 GPT-5.5、Claude Opus 的 4 倍；使用成本不到其他前沿模型一半，特别适合处理长周期智能体任务，可大幅缩短复杂工作耗时。

(来源：快科技)

OpenAI 承诺投资逾 3 亿新元，在新加坡设立其海外首个应用型 AI 实验室

OpenAI 承诺投资逾 3 亿新元，在新加坡设立其海外首个应用型 AI 实验室。OpenAI 表示，未来数年其在新加坡的岗位规模将扩充至约 200 个，并计划向新加坡投入超 3 亿新加坡元资金。OpenAI 将与新加坡携手合作，推进人工智能应用领域创新、培育人工智能专业人才，同时推动人工智能技术惠及普通民众、各类企业及公共部门。

(来源：IT 之家)

2nm 以下芯片倒计时！ASML 官宣最强光刻机即将出货首批芯片

ASML CEO 傅格礼宣布，首批采用新一代 High-NA EUV 光刻机制造的 2nm 以下逻辑与存储芯片将在未来数月问世。该设备单台造价约 4 亿美元，分辨率提升可实现 66% 的特征尺寸缩小；英特尔已安装两台并处理超 3 万片晶圆，计划 2027-2028 年量产 14A 制程，SK 海力士今年将导入该技术生产下一代 DRAM。

(来源：快科技)

字节 Seedance 上戛纳了 带着全球首部 95 分钟 AI 电影

全球首部 95 分钟 AI 长片《Hell Grind》在戛纳首映，反响热烈。提前观看了粗剪片段的好莱坞导演 Chuck Russell 评价，“你们让我真正共情片中角色，这在 AI 影视作品里几乎难得一见。”

(来源：TechWeb)

超越 GPT-Realtime-2，阿里语音大模型获三项第一

阿里巴巴语音大模型 Fun-Realtime-ASR 和 Fun-Realtime-AudioChat 在全球权威 AI 评测平台 Artificial Analysis 登顶，超越 GPT-Realtime-2 等国际顶尖模型，在“听准（词错误率）”、“听懂（语音推理）”和“会聊（对话流畅度）”三项指标上斩获第一。

(来源：TechWeb)

阿里 MuleRun 陈宇森：AI Native 团队效率是 Copilot 团队 10 倍，企业转型窗口期仅 18 个月

在 2026 阿里云峰会上，阿里云智能集团副总裁、MuleRun（骡子快跑）负责人陈宇森阐述了 MuleRun 为企业和个人实现 AI Native 转型提供的方案，覆盖接入层、生产层和协同层。陈宇森表示，MuleRun 团队在观察了上千位企业

用户后发现，AI Native 团队和 Copilot 团队之间的效率差高达 10 倍，而企业实现 AI Native 转型的窗口期通常仅有 18 个月。

（来源：TechWeb）

阿里云重磅发布金融级智能体平台点金

在 2026 阿里云峰会上，阿里云正式推出金融级通用智能体点金，直连市场行情、阿里资产，并原生支持 Wind 万得、盈米且慢、东方财富、恒生聚源等数据源，内置全链路审计与三重合规防线。通过零代码配置与混合算力架构，点金可实现毫秒级响应及异构渠道统一接入，助力金融机构的计算准确可信，决策透明可靠。

（来源：阿里云）

亚马逊科技推出“智能代理流程转型”资助项目，助力合作伙伴加速 Agentic AI 驱动转型

亚马逊科技中国合作伙伴峰会今日举行。峰会期间，亚马逊科技正式推出“智能代理流程转型”（Agentic Process Transformation, APT）资助项目，旨在赋能合作伙伴打造能够助力企业将传统业务流程转化为由 Agentic AI 驱动的创新解决方案，从而实现企业的降本增效和业务增长。此外，4 家合作伙伴获得了亚马逊科技 2025 年度各项合作伙伴奖项。

（来源：TechWeb）

特斯拉陶琳：Model S/X 产线将改造为人形机器人产线

特斯拉公司副总裁陶琳今天在微博表示，Model S / X 签名版刚刚在美国加州弗里蒙特工厂下线，该产线将很快改造为特斯拉人形机器人的产线，承担人工智能时代里更重要的任务。

（来源：IT 之家）

Anthropic 联合创始人克拉克预测 AI 进化：18 个月内纯 AI 公司创收数百万美元

Anthropic 联合创始人杰克·克拉克（Jack Clark）发表预测，勾勒了未来 2 年的 AI 进化时间表。他在牛津大学演讲时预测进化情况如下：未来 12 个月内，AI 将与人类合作产出诺贝尔奖级发现；2 年内，双足机器人将辅助技工；18 个月内，纯 AI 运营公司将创造数百万美元营收；到 2028 年底，AI 系统或可设计自己的继任者。

（来源：IT 之家）

英伟达 Vera Rubin 下半年量产 推理性能比 Blackwell 高 35 倍

英伟达 CEO 黄仁勋透露，公司计划于今年下半年开始生产和发货下一代机架级人工智能系统——Vera Rubin。该系统整合了七大专用芯片和五大加速机架，相较于当前的 Blackwell 架构，推理吞吐量提升 35 倍，AI 工厂营收能力提高 10 倍。

（来源：快科技）

7. 历史报告回顾

一、云计算（SaaS）类：

- 1、云计算行业深度系列 1：《飞云之上，纵观 SaaS 产业主脉络：产业-财务-估值》
- 2、云计算行业深度系列 2：《海外 SaaS 启示录》
- 3、云计算行业深度系列 3：《港股篇-挖掘最具成长性的港股 SaaS 赛道》

二、金融科技类：

- 1、银行 IT 行业深度：《分布式，新周期》
- 2、万亿蚂蚁与产业链深度研究：《蚂蚁集团：成长-边界-生态》
- 3、数字货币行业深度_总篇：《基于纸币替代的空间与框架》
- 4、数字货币行业深度_生态篇：《大变革，数字货币生态蓝图》

三、智能驾驶类：

- 1、智能驾驶系列 1：《重构产业链生态》
- 2、智能驾驶系列 2：《智能驾驶核心——软件！》
- 3、智能驾驶系列 3：《激光雷达，汽车智能化中的黄金赛道》
- 4、行业跟踪：《从 L9 看汽车智能化新趋势》
- 5、行业跟踪：《问界 M7 软件价值几何？》

四、人工智能类：

- 1、80 页深度：《全球科技股复盘-云的下一站：AI》
- 2、ChatGPT 深度(11)：《华为算力分拆-全球 AI 算力的第二极》
- 3、Chatgpt 海外模型应用复盘：《国内 AI 奇点已至》
- 4、行业跟踪：《海外 AI 高景气度，A 股科技静待花开》
- 5、Sora 行业跟踪：《算力应用再加速》
- 6、AIGC 行业深度：《Sora 算力倍增，国产架构+生态崛起》

五、工业软件类：

- 1、工业软件系列 1：《工业软件，中国制造崛起的关键》
- 2、工业软件系列 2：《CAX 类工业软件，打破欧美数十年技术垄断》
- 3、工业软件系列 3：《CAD&PLM 迎来“黄金十年”》

六、鸿蒙系列：

- 1、行业点评：《鸿蒙 4.0 大模型加持，小艺脱胎换骨》
- 2、行业点评：《鸿蒙 5.0 将至，鸿蒙生态已过万重山》
- 3、行业专题：《鸿蒙千帆起，生态全面启动》
- 4、行业点评：《HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版发布，鸿蒙生态千帆起》

七、新能源 IT：

- 1、新能源 IT 深度（九）：《储能 IT，百亿市场亟待解锁》
- 2、新能源 IT 深度（十）：《从虚拟电厂商业模式看千亿空间》
- 3、新能源 IT 深度（十一）：《虚拟电厂，山雨欲来风满楼》
- 4、新能源 IT 深度（十二）：《新型电力系统视角下的能源 IT 研究框架》

八、信创：

- 1、信创系列（三）：《把握能源信创价值洼地》
- 2、信创系列（四）：《数据库：信创的关键环节》
- 3、信创系列（五）：《信创时代，国产 ERP 迎来发展良机》
- 4、信创系列（六）：《“三维度”验证信创加速》

九、数据要素：

- 1、行业跟踪：《重视数据催化与数据要素政策预期》
- 2、数据要素深度报告（三）：《擘画数字经济新蓝图》
- 3、数据要素深度报告（四）：《启动按钮，“数据要素”释放》
- 4、行业点评：《数据要素X》正式落地，政策与资金齐发力！

十、其他：

- 1、网络安全龙头深度：《奇安信：狼性的网安新龙头》
- 2、网络安全深度报告：《拨开云雾见天日，守得云开见月明》
- 3、计算机行业 2023 年策略报告：《安全为根，枝繁叶茂》
- 4、行业深度：《国企改革：“科技产业”大变局》

8. 风险提示

市场系统性风险、科技创新政策落地不及预期、中美博弈突发事件。

分析师承诺

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

评级说明

公司评级标准	投资 评级	说明
以报告发布日后的 6 个月内公司股价相对上证指数的涨跌幅为基准。	买入	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数达到或超过 15%
	增持	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数在 5%—15%之间
	中性	分析师预测在此期间股价相对上证指数在-5%—5%之间
	减持	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数 5%—15%之间
	卖出	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数达到或超过 15%
行业评级标准		
以报告发布日后的 6 个月内行业指数的涨跌幅为基准。	推荐	分析师预测在此期间行业指数相对强于上证指数达到或超过 10%
	中性	分析师预测在此期间行业指数相对上证指数在-10%—10%之间
	回避	分析师预测在此期间行业指数相对弱于上证指数达到或超过 10%

华西证券研究所：

地址：北京市西城区太平桥大街丰汇园 11 号丰汇时代大厦南座 5 层

网址：<http://www.hx168.com.cn/hxzq/hxindex.html>

华西证券免责声明

华西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司签约客户使用。本公司不会因接收人收到或者经由其他渠道转发收到本报告而直接视其为本公司客户。

本报告基于本公司研究所及其研究人员认为的已经公开的资料或者研究人员的实地调研资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载资料、意见以及推测仅于本报告发布当日的判断，且这种判断受到研究方法、研究依据等多方面的制约。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及预测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息始终保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者需自行关注相应更新或修改。

在任何情况下，本报告仅提供给签约客户参考使用，任何信息或所表述的意见绝不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告视为做出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在任何情况下，本报告均未考虑到个别客户的特殊投资目标、财务状况或需求，不能作为客户进行客户买卖、认购证券或者其他金融工具的保证或邀请。在任何情况下，本公司、本公司员工或者其他关联方均不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告而导致的任何可能损失负有任何责任。投资者因使用本公司研究报告做出的任何投资决策均是独立行为，与本公司、本公司员工及其他关联方无关。

本公司建立起信息隔离墙制度、跨墙制度来规范管理跨部门、跨关联机构之间的信息流动。务请投资者注意，在法律许可的前提下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的前提下，本公司的董事、高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为华西证券研究所，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。